



DATA-03



VIA Technologies Japan 株式会社

# 製品カタログ

2024 - 2025

# 目次

## 目次

VIA グループ	2
VIA のコアコンピタンス	4
VIA 組込み ARM ソリューション	6

## 特集

VIA 組込み向け Android 開発用ツール～ Smart ETK	7
Smart ETK を使用するメリット	8
VIA Edge AI Solution	10
AI/IoT 向けプラットフォーム	12
エッジ AI 特化型ソリューション	14
MaaS 向けソリューション	16
車載 IoT 向けソリューション	18
AI フォークリフト安全システム	20

AI/IoT 製品	22	VIA Mobile360 製品	30
SOM-7000	23	VIA Mobile360 D700	31
SOM-5000	23	VIA Mobile360 M800	31
SOM-3000	24	VIA Mobile360 M500	32
VAB-7000	24	IVT 01	32
VAB-5000	25		
VAB-3000	25		
VAB-630	26		
ARTiGO A7000	26		
ARTiGO A5000	27		
ARTiGO A3000	27		
Access Control System (POC)	28		
EPIA-M930	28		
AMOS-3007	29		



## VIA Technologies, Inc

VIA Technologies, Inc. は、業務の安全性と効率性を変革するインテリジェントな車載、エッジ、産業機器、ビルディングソリューションにより、高度な AI、IoT、コンピュータビジョン技術と企業を結び付ける世界的なリーダー企業です。

VIA は、PC 用コアロジックチップセットの開発に特化した工場を持たない半導体設計会社として、1987 年に米国カリフォルニア州のフリーモントで設立されました。当社は 1992 年、台湾とアジアにおいて重要かつ成長を見せしている IT 製造拠点との緊密なパートナーシップを構築するために、本社を台湾の台北に移しました。

VIA は 1990 年代に、Intel および AMD の x86 プロセッサをサポートする複数世代の画期的な製品を発売し、コアロジックチップセットの市場において世界的なリーダー企業となりました。当社は、新しいタイプの高集積・低消費電力コンピューティングプラットフォームを開発する必要性を認識し、1999 年に当時は National Semiconductor の一部門であった Cyrix、および Integrated Device Technology から Centaur Technology を買収し、x86 マイクロプロセッサ市場に参入しました。VIA はその技術力をさらに高めるため、2001 年に合併企業である S3 Graphics を設立したほか、ネットワーク、ワイヤレス、USB コントローラの幅広いチップを開発しました。

VIA は、VIA C3、VIA Eden、VIA Nano、VIA QuadCore プロセッサの歴代製品を発売するとともに、産業、輸送、医療、スマートシティアプリケーションにおける低消費電力 PC および組み込みシステムの業界標準となった、Mini-ITX や Pico-ITX といった高集積・超小型マザーボードのフォームファクタを先駆けて開発しました。

VIA は、半導体設計、コンピュータビジョン、コンパクトかつ高耐久性のシステム設計における豊富な経験と専門知識を活用し、企業が業務の安全性、効率性、持続可能性を変革できるようにする新世代のインテリジェントソリューションにより、技術的なリーダーシップをさらに拡大しています。

高度な AI、コンピュータビジョン、およびクラウドの技術を強力に信頼性の高いシステムやデバイスと組み合わせた VIA のインテリジェントなエッジ、車載、産業機器、ビルディングソリューションは、企業が豊富な IoT およびビジュアルデータを活用し、最も要求の厳しい環境やユースケースに対して運用を最適化する無限の可能性を切り開きます。

## VIA インテリジェントエッジソリューション

VIA インテリジェントエッジソリューションは、高集積のモジュール、ボード、スターターキット、システムの幅広い選択肢で構成され、小売、商用、産業用の革新的なエッジ AI デバイスの市場投入までの時間を短縮します。高度なコンピューティングおよび AI 性能と、低消費電力および I/O・接続の豊富な機能を結び付けた VIA インテリジェントエッジソリューションには、システム開発を容易にする Android や Linux の BSP (ボードサポートパッケージ) も付属しています。

最高水準の品質と信頼性により構築された当社のプラットフォームは、長期間の製品ライフサイクルをサポートするため、長期安定供給を実現しています。

## VIA インテリジェント車載ソリューション

VIA インテリジェント車載ソリューションには、幅広い VIA Mobile360 のシステムおよびデバイスが含まれ、AI を活用した人検出およびドライバー安全システム技術の包括的なパッケージを活用して、オンロード・オフロードの商用車両における事故を防止し、効率性を高めます。堅牢かつ高信頼性の幅広いフォームファクタで利用可能な VIA インテリジェント車載ソリューションは、採掘や建設に用いられる掘削機や運搬トラックから、物流や輸送に用いられるフォークリフトや配送用バンまで、特定の導入要件を満たすために、あらゆるサイズ・種類の商用車両および産業用車両に搭載することができます。

VIA Fleet および VIA WorkX プラットフォームを使用したシームレスなクラウド接続により、管理者は豊富なリアルタイムの IoT およびビデオデータを使用して、車両運行上の安全性と効率性を最適化することができます。

## VIA インテリジェント産業機器ソリューション

VIA インテリジェント産業機器ソリューションは、最適化された AI 外観検査モデルおよび強力なエッジ AI 機能を活用して、パイプライン溶接、ビニール袋の製袋加工、シリコンウエハといったさまざまな項目の不良検出におけるスピードと精度を向上させます。

また、煙、火災、個人用保護具の安全性検査ソリューションも利用可能であり、商品や施設の損傷を防ぎ、潜在的な安全上の脅威から従業員を保護します。すべてのソリューションは、最新の AI、コンピュータビジョン、産業機器用 IoT 技術を活用して、特定の導入要件に合わせてカスタマイズすることが可能です。

## VIA インテリジェントビルディングソリューション

VIA インテリジェントビルディングソリューションには、住宅用および商業用の導入に理想的な最先端のカメラと接続技術を統合したスマートアクセス制御、ビデオインターホン、ドアベル、アラームシステムなどがすべて含まれています。特定の導入ニーズを満たす、柔軟なカスタマイズオプションが利用可能です。

# x86

# ARM



## VIA のコアコンピタンス

1987年の設立以来、チップセットのリーディングカンパニーとして業界の最先端を走ってきたVIA。しかし、私たちがご提供できる製品は、チップセットだけではありません。VIAは、各種ハードウェアはもちろん、ハードウェアの性能を最大限に引き出すミドルウェアの開発支援、半導体レベルからのサポートまでを含めたシステムをご提案のできるソリューションメーカーなのです。

お客様システムに合わせてほかのボードメーカーが実現できない BIOS のカスタマイズやドライバのチューニングができること。ボード、システムの心臓部となる CPU、チップセット、周辺 IC を熟知していることによる高い問題解決力。それらが私たちの最大の武器となっています。

## 優れたコストパフォーマンス



VIAは、お客様のご要望に合わせて、最もコストパフォーマンスの高いソリューションをご提案します。VIAのソリューションなら、ドライバのチューニングやソフトウェア開発支援によって、ハードウェアの性能を最大限まで引き出し、TCO(Total Cost of Ownership)を抑えながら、お客様が求める必要なパフォーマンスを実現させることができます。

## トータルソリューション提案



VIAが顧客に対して提案できるものは、単なるマザーボードに留まらず、顧客が実現したいことを具体的な形で（ハードウェア+ソフトウェアを通じたシステム観点から）ご提案できることが重要なポイントだと考えています。顧客に製品コンセプトやビジネスモデルに注力していただき、VIAがそのアイデアを製品化させるお手伝いをする Win-Win モデルの推進を心がけています。

## 省電力



VIA製品特徴の一つとしては、1ワットあたりのパフォーマンスの高さ。ハイパフォーマンスな製品を導入したところで、それが本当に必要とするスペックでなければ、無駄にコストをかける及び電力を消費するだけです。VIAは、お客様のアプリケーションに必要なパフォーマンスに合わせて、低消費電力（TCO削減）の製品をご提案することができます。選択肢がないからと、不必要にハイパフォーマンスな製品を導入されることはありません。

## 単一窓口



ハードウェアの問題だけでなく、ドライバやファームウェアのようなミドルウェアファームウェアの問題もVIA一社で解決できます。窓口を一本化していることも、VIAのソリューションが選ばれるひとつの理由です。共同開発のパートナーとして、部品レベルの開発からBIOS、ドライバなどのソースレベルのサポートまでを一貫して行うため、お客様の安心感が違います。また、当社はLinux系にも強く、他社では対象外となるLinuxもきちんとサポートします。

## VIA のサービス & サポート



ハードウェアとミドルウェアを自社開発しているのがVIAの強みです。そのメリットは、ハードからソフトまで、お客様の要望に合わせて自在にカスタマイズできます。また、システムの根幹から理解しているメリットは、トラブル発生時のサポートにも生かされています。部品を寄せ集めた他社のソリューションでは困難な、本当の意味での問題解決ができるのもVIAならではの強みです。

# VIA 組み込み ARM ソリューション

x86 系の開発技術を ARM 製品に活かす



## VIA は ARM テクノロジーを採用

VIA は一貫とした製品開発コンセプト「省電力」、「省スペース」、「高コストパフォーマンス」に基づいて、x86 テクノロジーの他に、ARM テクノロジーも採用することになりました。ARM テクノロジーは電力効率に優れた上に、処理能力も大幅に進化し、様々な分野に急速に拡大していることで注目を浴びています。



## VIA 組み込み ARM ソリューションが選択される理由



### ミドルウェア開発能力

VIA は、一般的なボードメーカーと異なる強みがあります。これは、CPU、チップセットメーカーであり、グラフィックチップも開発していたデバイスメーカーのノウハウから、OS とアプリケーションを橋渡しするミドルウェアのカスタマイズ、開発を得意としています。開発者はアプリケーションの開発に専念して頂けます。

開発時間の短縮



### 長期安定供給

VIA は顧客に対する持続的なコミットメントとして、ARM 製品に関する 7 年以上の製品寿命のサポートを提供致します。製品の長期安定供給によって、顧客が頻繁にモデルチェンジする必要なく、TCO(Total Cost of Ownership)の削減にも繋がります。

TCO の削減

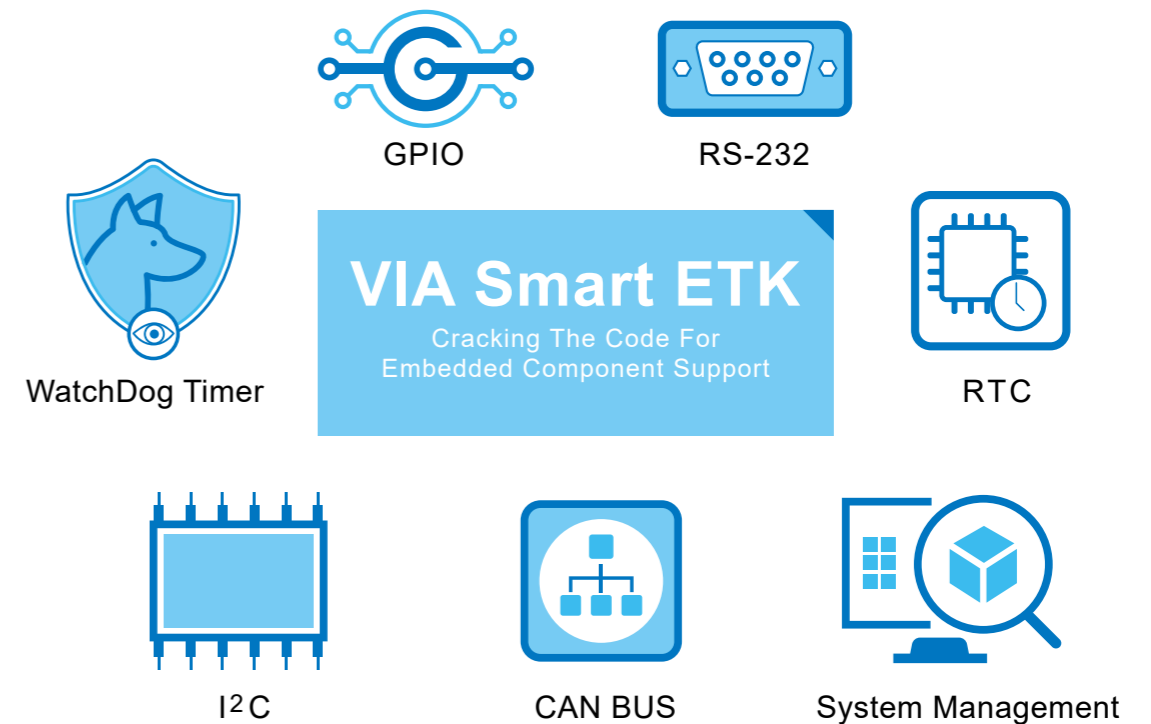


### 産業用レベル高品質

VIA 製品は全て厳格な QA 体制に基づいて製造されています。ボードデザインの段階から製造まで産業用レベルの使用環境に耐えられる信頼性テストを行っているため、厳しい環境でも安心して使用していただけます。量産後も継続的に品質監視システムがあるため、継続的に高品質を維持することができます。

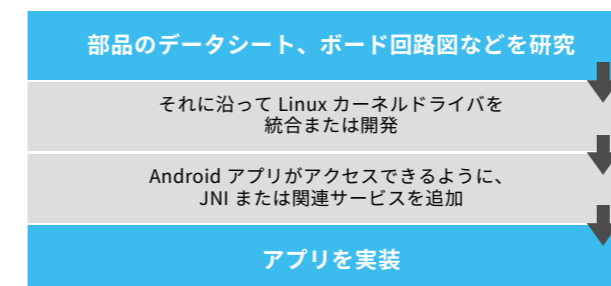
厳格な品質管理

# VIA 組み込み向け Android 開発用ツール ~ Smart ETK



Android は、その安定した長期のアプリケーション開発フレームワーク、広範囲な開発者リソース、高性能のネイティブ・マルチメディア機能、親しみやすいユーザーインターフェース、カスタム化性能、市場までの時間とコストの削減といった特徴を利用して、画期的な新しい組み込みシステムと装置の開発を可能にする、心を躍らせる能力を秘めています。

## I/O へアクセスする一般的な方法



### Smart ETK がないと

1. 周辺装置向けのドライバの開発や調整が必要
2. Android BSP の調整が必要
3. ソフトウェアとハードウェアの統合が困難

## Smart ETK があれば



### Smart ETK があれば

1. アプリケーションが API を正確に使用することによって、簡単かつ便利に周辺装置を制御することができる
2. 開発資源の投入を抑え、製品信頼性を高める

# Smart ETK を使用するメリット

独自の Android 開発ツール



VIA Smart ETK には、Android アプリケーションが I/O にアクセスするのを可能にする一連の API および Android フレームワークでサポートされないシステムハードウェアによって提供される管理機能サービスが含まれます。これらの API により、システムのクラッシュ防止のサポート、電源オン・オフのスケジュール機能、ならびに最大のパフォーマンスを確実にする、定期的なシステム再起動が提供されます。



## ウォッチドッグ

これは、適切な動作を確実にし、アプリケーション / システムが停止サイクルまたは故障から復帰するのを助けるタイマーをユーザーが設定できる API を提供します。これが設定されると、「ドッグタイマー無効」信号が受信されない場合、システムは自動的に再起動します。



## RTC ウェイクアップ

これは、リモートタイムクロック (RTC) 自動ウェイクアップタイマーを設定することによって、自動電源オン機能を提供します。この RTC は、以下の3つの自動ウェイクアップモードをサポートします。

- 毎日指定された時刻にウェイクアップ
- 毎週指定された日時にウェイクアップ
- 毎月指定された日時にウェイクアップ



## システム電源オフ / 再起動

これは、ユーザーが Android アプリケーションを使って、システム電源オフのスケジュールや、最大のパフォーマンスが確実に維持されるように定期的な再起動を設定できるようにする API を提供します。



## レガシー I/O サポート

Smart ETK は、アプリケーションにおいて、RS-232、GPIO、I2C および CAN バスポートといったレガシー I/O サポートを可能にします。

一般民生機器 外部とのアクセス手段は： USB, Bluetooth

カメラ タッチパネル 加速度計 GPS E-Compass

組み向け用途機器 外部とのアクセス手段は： USB, RS-232, GPIO, LAN

CAN BUS LAN RS-232 GPIO WatchDog Timer

特許取得済

標準 Android フレームワークでは対応できない

VIA Smart ETK なら I/O に直接アクセス可能な API を提供

### メリット 1 開発期間が短縮できる

- ・コスト削減
- ・Time-To-Market

### メリット 2 システムの安定性が高まる

フレームワークをカスタマイズしていないため安定性が高まる

### メリット 3 アプリが移行しやすい

フレームワークのリビジョンに左右されないため、アプリが移行しやすい

# VIA Edge AI Solution

すぐに使える VIA のエッジ AI 標準ソリューションとカスタムソリューション

## STANDARD

### VIA Edge AI "Ready to Go"

いち早く市場に導入可能

### VIA Edge AI "Custom"

オリジナル性

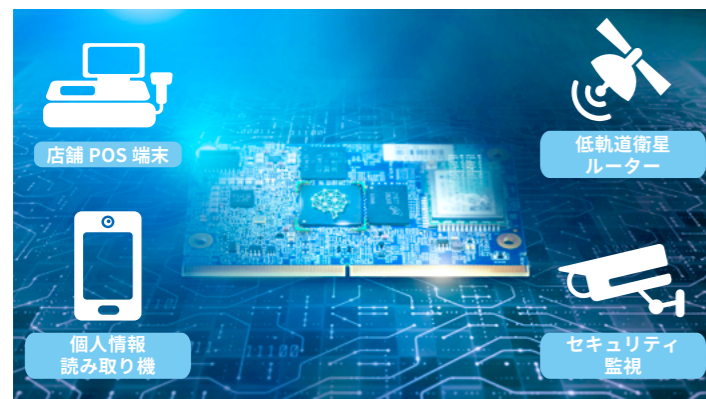
## CUSTOM

世界はソフトウェア 1.0 からソフトウェア 2.0 へと進化し、アプリケーションとアクティビティは、ますますソフトウェア定義へと進化しています。また CPU アーキテクチャも、PC エコシステムからスマートフォンエコシステムへと進化しており、サプライチェーンの経済性やソフトウェア開発も ARM エコシステムに移行しています。

そこで VIA では、いち早く市場に導入ができるスタンダードなソリューション VIA Edge AI "Ready to Go" と、オリジナル性を持ったカスタムなソリューション VIA Edge AI "Ready to Go" を用意しました。

### VIA Edge AI "Ready to Go"

VIA には、すぐに使うことができ、いち早く量産化して市場へ投入ができるスタンダードな Edge AI 製品として、VIA Mobile360 ソリューションと AI/IoT ソリューションがあります。



### AI/IoT 標準品 (プラットフォーム)

VIA Edge AI "Ready to Go" ソリューションである Edge AI 製品には、ARM 社の SoC を活用する AI と IoT を組み合わせた AI/IoT プラットフォームが活用されています。VIA の SOM は、製品検査、音声認識、セキュリティ監視に応用する製品があります。



### VIA Mobile360 標準品 (車載ソリューション)

車載ソリューションである VIA Mobile360 は、VIA Edge AI "Ready to Go" に属するスタンダードな Edge AI 製品です。顧客がソフトウェアさえ開発すれば、すぐに量産でき、いち早く市場に導入できる Edge AI 製品です。VIA Mobile360 は最も要求の厳しい舗装路およびオフロード環境向けに設計されており、車両の安全性と効率を高めます。

### VIA Edge AI "Custom"

VIA では、いち早く市場への導入が可能な Edge AI のスタンダード製品のほか、用途ごとにオリジナルなカスタム設計ができる VIA Edge AI "Custom" の設計・開発も行っています。

VIA Edge AI "Custom" は、VIA Edge AI "Ready to Go" の標準ソリューションにオリジナルなカスタム設計を行い、様々な分野に展開できる製品を提供します。設計から生産まで、VIA の確実な検証、制御、フローのもと、顧客のご要望に応じた VIA Edge AI カスタム製品を製造します。



VIA では、製品ニーズに対して迅速な対応を行うために、熱や気流、機械 3D、信号品質、無線周波数に関するシミュレーションができる試験設備のほか、環境試験設備や電気試験設備も備えています。



VIA は、すぐに使うことができ、いち早く量産化して市場へ投入ができるスタンダードな Edge AI 製品 VIA Edge AI "Ready to Go" と、用途ごとに顧客オリジナルなカスタム設計ができる VIA Edge AI "Custom" の両方に対応しています

# AI/IoT 向けプラットフォーム

MediaTek Genio シリーズソリューション

## VIA 製品を導入するメリット

### SoC 設計の専門知識

VIA は一般のボードメーカーと違って、ARM の SoC を自社開発ができる技術力を持つ半導体メーカーでもあります。x86 系製品から累積してきた経験及びノウハウを ARM 製品に生かし、信頼性の高い組込み製品を長期安定供給を目指します

### 豊富なソフトウェア開発フレームワーク

VIA は組み込み向け Android に特許を取得した「SmartETK」という開発ツールを提供しています。SmartETK には、Android アプリケーションが I/O アクセスするのを可能にする一連の API 及び Android フレームワークでサポートされないシステムハードウェアによって提供される管理機能サービスが含まれます。また、AI アプリケーション向けに Android Neural Networks API へのサポートやサンプルコードの提供によって AI アプリケーション開発者がより開発しやすい環境を整えます。

### 市場投入までの時間短縮

SOM(System-On-Module) とは、SoC、メモリ、電源管理、通信コンポーネントなど、コンピュータの基本機能を凝縮したモジュールです。お客様は SoC 周りの設計を行う必要がないため、開発期間の短縮、開発費用の低減、市場投入までの時間短縮が可能です。SOM 製品以外に、すぐ使用できる SBC(Singel-Board-Computer) 製品やシャーシが付いているシステム製品を需要に応じて製品ラインナップを展開しています。



VIA AI/IoT 製品ラインナップは SOM(System-On-Module) 製品からシャーシ付きのシステム製品まで幅広く製品ラインナップをそろえています。SoC の種類もエントリーモデルからハイエンドモデルまで、MediaTek 製組込み向けの Genio シリーズを選択し、組込用途が必須とする長期安定供給が可能となります。Genio シリーズの SoC に全て AI 専用エンジン (APU) を搭載し、AI アプリケーションをフルに活用させることは可能です。

	Genio350	Genio700	Genio1200
SOM	SOM-3000	SOM-5000	SOM-7000
VAB	VAB-3000	VAB-5000	VAB-7000
ARTiGO	ARTiGO A3000	ARTiGO A5000	ARTiGO A7000

## AIトレンドと活用

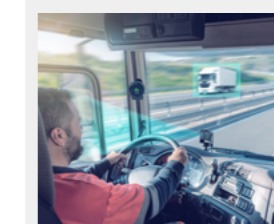
近年技術の進化によって AI アプリケーションは様々な産業に活用されています。使用シーンによってクラウド AI とエッジ AI がそれぞれ重要な働きをしています。特にエッジ AI は操作している端末内で推論を行うため、利用者が求める判断をすばやくアウトプットすることができるため注目が浴びています。

### 製造業・工業生産



- ・機械の故障を予測・告知
- ・機械の異常を検出
- ・ベルトコンベヤーに流れている商品の不良品を検出・排除

### 交通



- ・先進運転支援 (ADAS)
- ・ドライバー安全システム支援 (DSS)
- ・ナンバープレートの自動検出

### 教育



- ・校庭の自動監視
- ・生徒の行動や表情をトラッキング
- ・教師の説明をリアルタイム文字化

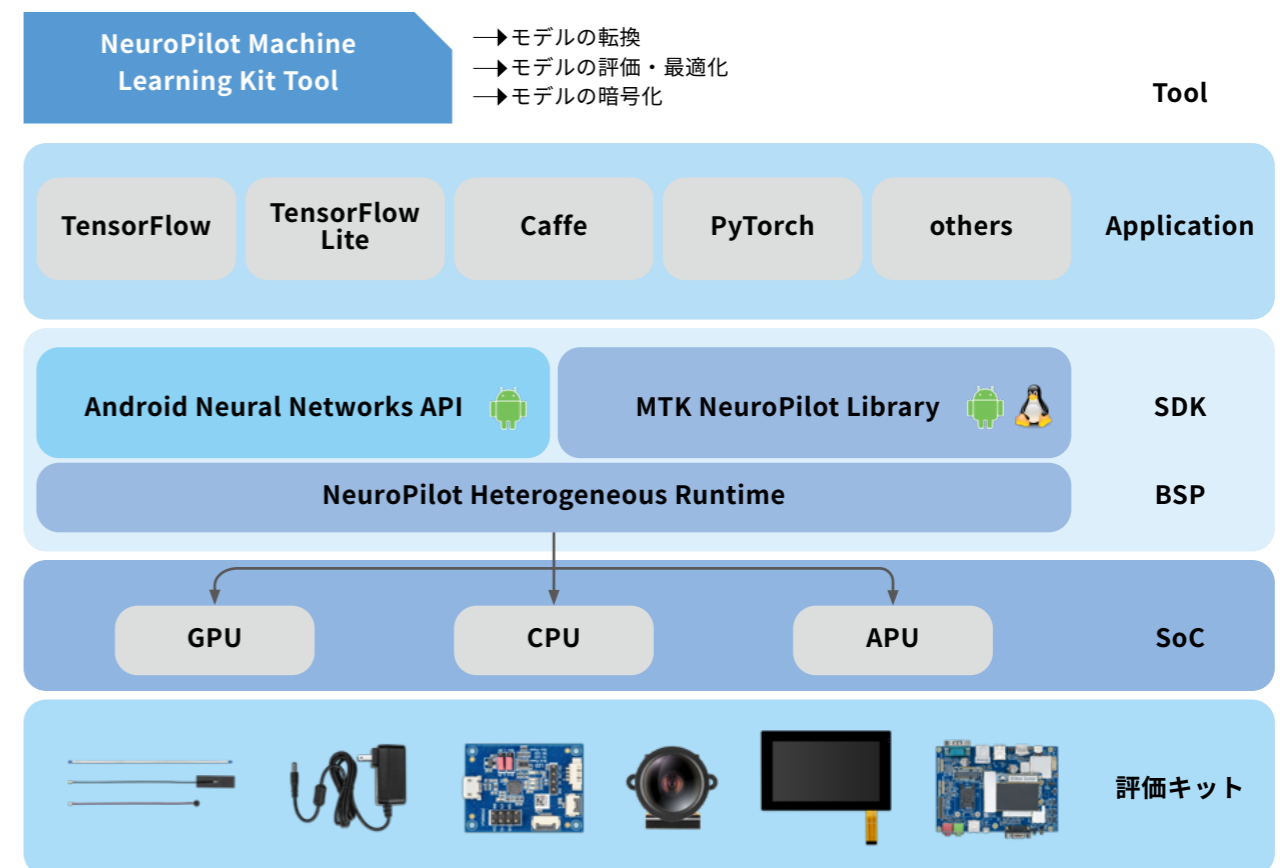
### 小売業



- ・万引検知
- ・顧客の店舗内の行動パターン分析
- ・セキュリティ支援

## AI 向け開発ツール及び評価キット

VIA AI/IoT 製品は MediaTek 製 Genio シリーズを採用し、全シリーズに AI 専用計算エンジン (APU) が搭載されているため、エントリーの AI からハイエンド AI まで幅広く対応できます。AI 開発ツール MTK NeuroPilot SDK を使用することによって、AI 処理を自動的に APU や GPU、CPU に振り分けることができますので、AI パフォーマンスを最大限に発揮することが可能です。VIA の AI/IoT 評価キットでいち早く POC を開発することができます。





# エッジ AI 特化型ソリューション

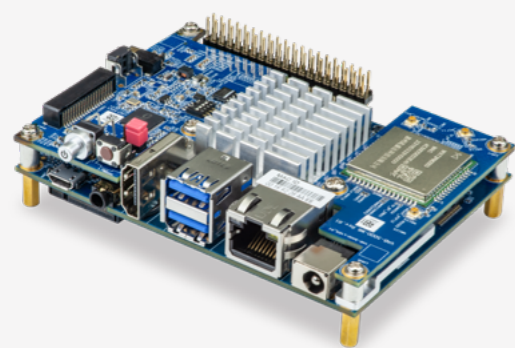
Pico-ITX フォームファクターのコンパクトなシングルボードコンピュータ



## VAB-5000

Pico-ITX フォームファクターのコンパクトなシングルボードコンピュータ

Edge AI に最も適した市場を考え、必要な機能を備えたシングルボードコンピュータの設計から生まれた VAB-5000。スクリーンやカメラに対応し、幅広い接続性能とインターフェースを備えることで高度な Edge AI システムを生み出すほか、新たなデバイスの開発を加速させます。



ハードウェアには、「ビッグコア」である Arm Cortex-A78 CPU × 2 と「高効率コア」である Cortex-A55 CPU × 6 を搭載するオクタコア CPU の MediaTek Genio 700 を採用しています。この SoC は 6nm プロセスを実現し、低消費電力とマルチタスク OS に最適な高パフォーマンスを実現します。

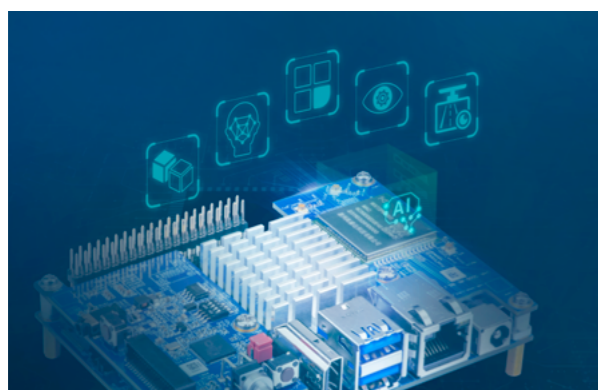
## AI エンジン搭載ゲートウェイ

ARTiGO A5000 システムには、ハイパフォーマンスな MediaTek Genio 700 オクタコア SoC と豊富な I/O 機能や接続機能を組み合わせた、コンパクトで耐久性に優れたファンレスシステムです。

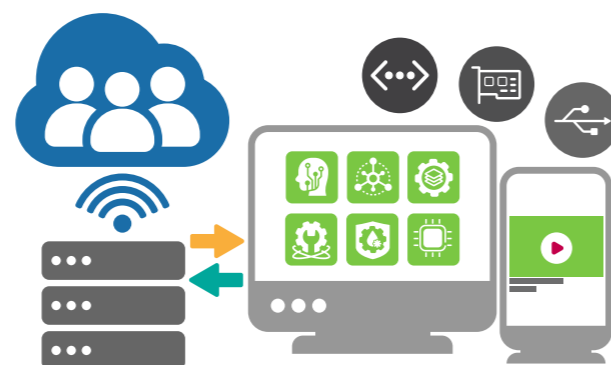


アンテナを内蔵しているので、設置が簡単で見た目もすっきりしています。筐体もコンパクトサイズなので、場所を選ばずに設置することができます。

PCI-Express 3.0/2.0、USB 3.1、GbE (ギガビットイーサネット)、MAC など、さまざまな高速インターフェースを使用できます。



VAB-5000 に搭載している、TOPS 4.0 の計算力を持つ AI カメラ向け高性能 AI エンジンシステムは、下記のようなカメラおよび映像向けのアプリケーションに適用できます。



VAB-5000 には複数のカメラおよびディスプレイを接続可能です。幅広い接続性とインターフェースを備えており、高速バス PCIe(PCI-Express)、USB 3.1、GbE(ギガビットイーサネット)および 4K など、最新のマルチメディア規格および 4K マルチディスプレイに対応します。



SOM(System-On-Module) とは、SoC、メモリ、電源管理、通信コンポーネントなど、コンピュータの基本機能を凝縮したモジュールです。お客様は SoC 周りの設計を行う必要がないため、開発期間の短縮、開発費用の低減、市場投入までの時間短縮が可能です。SOM 製品以外に、すぐ使用できる SBC(Singel-Board-Computer) 製品やシャーシが付いているシステム製品を需要に応じて製品ラインナップを展開しています。

# MaaS 向けソリューション

ドライブレコーダー型車両管理向けシステム



## VIA Mobile360 D700 AI ドライブ レコーダー



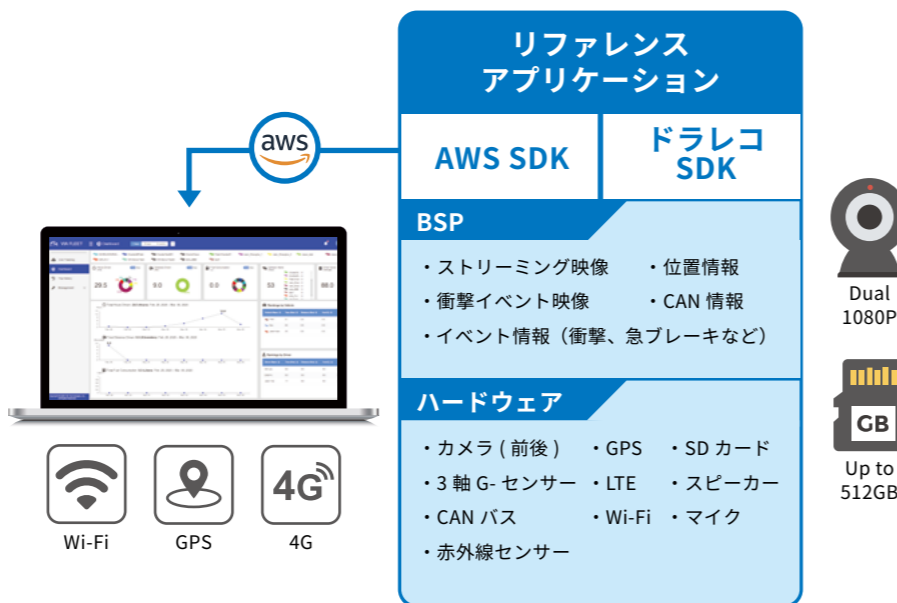
D700 に MaaS 向けに必要なとされるハードウェア機能及びソフトウェア機能を一つのパッケージとして提供します。標準の D700 を使用することによって簡単に貴社のオリジナル製品・サービスに導入することができるほか、個々の動作シナリオに合わせてリファレンスアプリをカスタマイズすることも可能です。

### 豊富なハードウェア機能

フロントカメラ・リアカメラ、二つのカメラが実装されたため、車両内外の状況を把握できるほか、赤外線センサーを搭載されていますので、高品質の夜間録画が可能です。また、GPS、G センサ、車速パルスにより、位置、衝撃、速度など、車両情報を全般的に取得することができます。

### 様々な通信手段

技適取得済みの LTE や Wi-Fi モジュールを搭載していますので、いつでも、どこでも、端末デバイスやクラウド経由で、即時に車両の状態を確認することができます。



### D700 ソリューションを導入するメリット



車両監視



走行車両情報の記録



運転習慣の改善



運営費用の検討

### すぐ動作可能なリファレンスアプリケーション付属

付属のリファレンスアプリケーションによって、ドライブ映像の常時録画やイベント情報の記録など、ドライブレコーダーに求められる機能を装備したほか、車両情報をクラウドへの送信や走行情報の分析なども行えます。

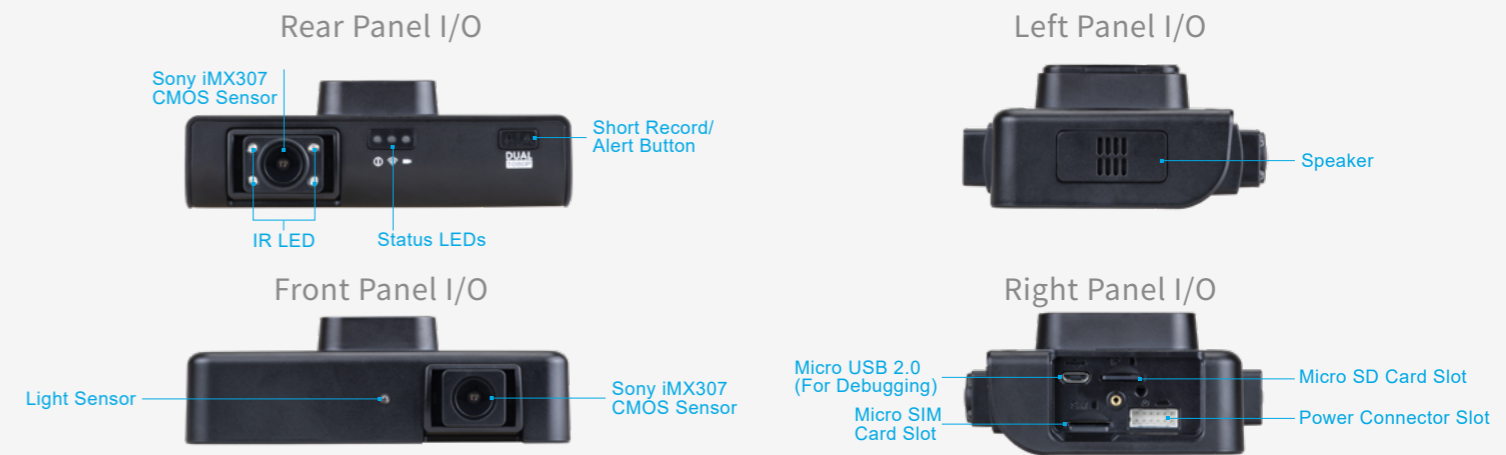
#### ドラレコ SDK

ドライブレコーダーのソフト開発に必要な API を提供します。短期間でオリジナルアプリケーションを開発することが可能となります。

#### AWS SDK

クラウド市場の中で最も利用されている AWS の IoT Core と Kinesis Video Streams(KVS) サービスに特化した SDK を提供します。VIA AWS SDK を通して、簡単に車両情報をクラウドに伝送し、幅広い業務を展開できます。

### スペック



### リファレンス Web ダッシュボード

クラウド上で、車両の監視、情報の収集、車両の管理を行います。



#### 常時車両追跡

- 地図位置
- 車両情報 (速度など)
- 動画ストリーミング
- 音声で運転手との連絡

#### ダッシュボード

- ガソリン消費
- フリート評価
- イベント発生時の統計

#### 履歴記録

- 各車両走行ルートの記録
- イベント発生時の録画

#### 車両管理

- 各車両の情報管理

### リファレンス携帯アプリ

クラウド上で、車両の監視、情報の収集、車両の管理を行います。



#### ライブストリーミング

- ライブ音声と画面

#### アルバム

- 常時録画
- 衝撃検知前後 10 秒の映像を自動で記録

#### 走行ルート記録

- 各車両の走行ルートの管理を簡単に

#### イベント統計

- 急ブレーキ、急発進の統計管理

# 車載 IoT 向けソリューション

車載エンタテインメントや運行管理向けシステム



## IVT01 AI 車載用タブレット



車載専用設計された AI タブレットシステム。組み向け長期供給可能な MediaTek 社製 Genio 500 AI プロセッサ、大容量 4GB LPDDR4 メモリー、16 GB eMMC 搭載。大きいサイズ (8.0")、高解像度 Full HD、静電容量方式タッチパネルで操作は簡単に。優れた拡張性と高い性能を備えており、タクシー、トラックなどの商用車の車載コンピュータとして使用することに最適。

## スペック



## 導入するメリット

車載仕様	優れた拡張性	Android 対応
<p>車載向けに開発した高信頼性タブレット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9V-36V 専用電源 (ACC/BAT/GND)</li> <li>電圧瞬断対策</li> <li>アイドリングストップ対策</li> <li>電波ノイズ対策</li> <li>JIS 規格振動対策</li> <li>E マーク認証取得</li> </ul>	<p>豊富な I/O インターフェイスを装備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4G LTE/ Wi-Fi / Bluetooth 無線通信可能</li> <li>CAN / 2RS-232 / 5 GPIO / 2 USB 搭載</li> <li>車速パルス入力対応</li> <li>G センサー / 光センサー 搭載</li> </ul>	<p>汎用性が高い Android OS を採用。システム開発を簡単・スピーディーに</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Android 10 対応</li> <li>Android Neuro Network API で手軽に AI アプリ開発可能</li> <li>VIA 独自の開発ツール Smart ETK によって開発期間を短縮</li> </ul>

## 幅広い周辺機器との接続可能

お客様が既存の車載システムに接続するアプリを開発することが可能。ドラレコ、デジタコ、ガソリン、メーター、サイネージ等。

## 車載仕様

車載仕様ならではの高信頼性。  
-10~60°C 動作温度、0~95% 相対湿度の環境でも作動可能。ISO 16752 電圧瞬断規格合格、それにアイドリングストップしても 90 秒間電源供給が可能。

## AI-IoT 対応

APU を搭載し、Android Neuro Network API でリアルタイム画像認識をはじめさまざまな AI ニーズに対応するエッジコンピューティングハードウェアとして使用できる。

## 優れた拡張性

豊富な I/O インターフェイスを装備

- Power Input (ACC/IGN/BAT/GND)
- RS-232
- GPI (Speed Pulse)
- 5GPIO (4GPI + 1GPO)

AI-IoT  
機能搭載

B2B 向け  
特化機能

# AI フォークリフト安全システム

前方・後方人物検知機能付き、「ドライバーセーフティシステム」がドライバーと現場の安全を守る

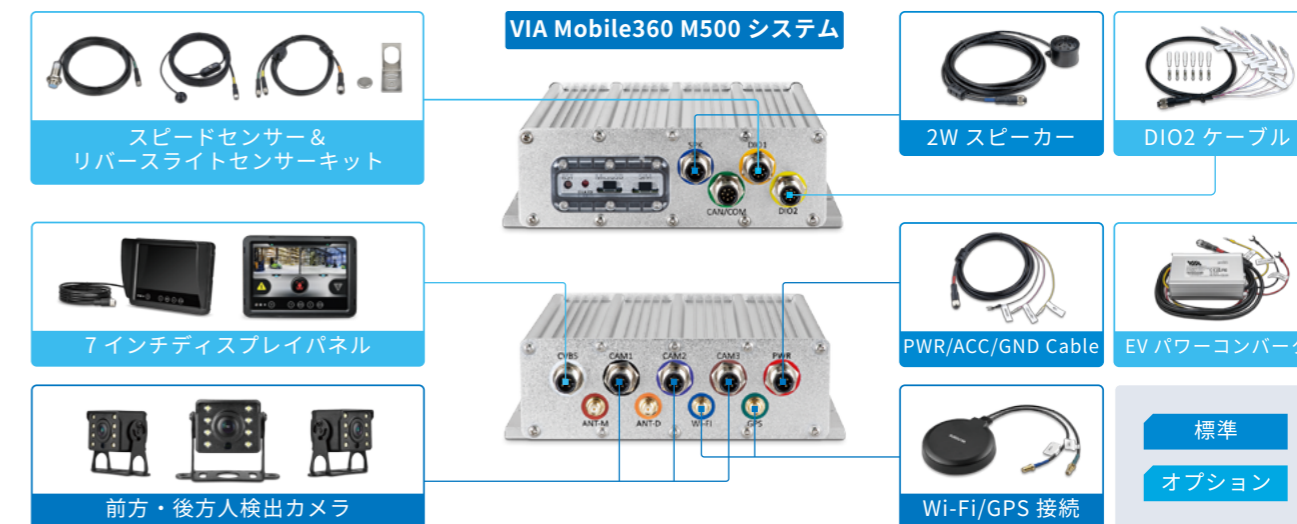


## VIA Mobile360 フォークリフト 安全システム



信頼性の高い ISO 16750-3 VII、IP67 防水防塵認証によって、幅広い現場を対応できます。多彩な各種パッケージと構成で利用でき、最大3台の歩行者検出カメラ、ドライバーカメラ、アラート用の高品質スピーカー搭載。豊富多様な I/O サポートでき、追加オプションとして7インチ CVBS ディスプレや車速およびバックセンサーが含まれます。

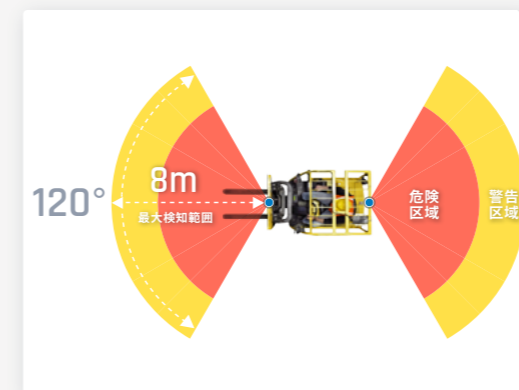
### システム構成



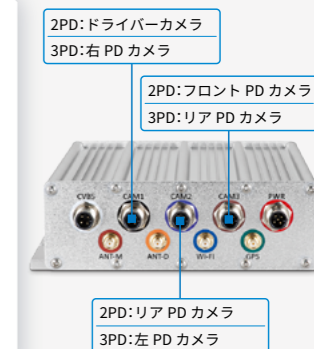
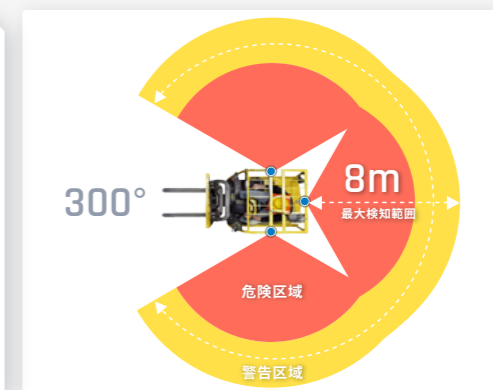
### 人検出

オプションの7インチ CVBS モニター、使いやすいインターフェースを搭載し、最大3台のカメラの画像をストリーミングし、ドライバーに簡単に認識させることができます。

#### 2PD Package 2 Camera Pedestrian Detection



#### 3PD Package 3 Camera Pedestrian Detection



### オペレーター行動

DSS (ドライバー安全システム) 搭載し、運転中の安全のため、ドライバーカメラを通して、疲労、喫煙、携帯電話の使用を検出するたびにアラートを出します。



### 豊富な視覚認識

オプションの7インチ CVBS モニター、使いやすいインターフェースを搭載し、最大3台のカメラの画像をストリーミングし、ドライバーに簡単に認識させることができます。



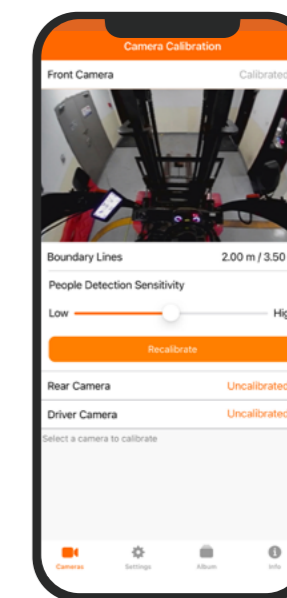
### VIA Mobile360 WorkX App

VIA Mobile360 WorkX のスマートフォンアプリを通して、最大3台のカメラの校正やシステムの設定、そしてシステムの Micro SD カードに保存されているビデオの表示とダウンロードが可能です\*

#### アプリ対応 OS

- Android 5.0 以降
- iOS 12 以降

\*ファームウェアを更新して頂く場合があります



# AI/IoT 製品

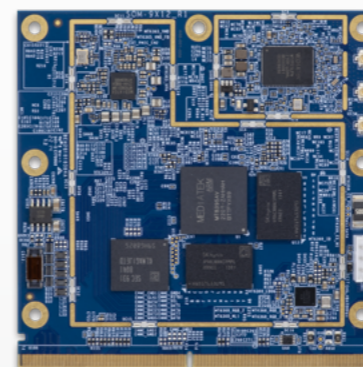
## 高性能高機能 SOM モジュール

### SOM-7000

MediaTek Genio 1200	eMMC 16GB
LPDDR4 8GB	GLAN x1



MEDIATEK



#### 1 MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな 4X Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

#### 2 高速バス対応

PCI-Express 3.0/2.0 と USB3.1 と GbE と 4K@90Hz 再生などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。

#### 3 TOPS4.8 AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4.8 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

部品番号	10GPZ22M30020
搭載 SoC	MediaTek Genio 1200 Octo-Core Process ·Quad-core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ·Quad-core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	16GB
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	2 MIPI DSI, 2 MIPI CSI-2, HDMI, Display Port, USB 3.1, 3 USB 2.0, GLAN, 2 SPI, 2 I2S, 3 I2C, 2 UART, 2 PCIe, SDIO, 4.3V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 80mm

## 高性能 SOM モジュール

### SOM-5000

MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
LPDDR4 4GB/8GB	GLAN x1



MEDIATEK



#### 1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

#### 2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

#### 3 高速バス対応

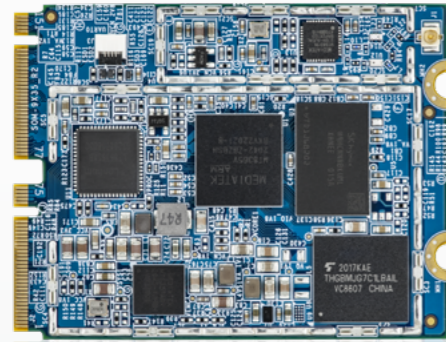
PCI-Express3.0/2.0 と USB 3.1 と GbE と 4K@60Hz 再生 などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ·Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ·Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	4GB/ 8GB LPDDR4X SDRAM
ストレージ	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	2 MIPI DSI, 2 MIPI CSI-2, HDMI, Display Port, USB 3.1, 3 USB 2.0, GLAN, 2 SPI, 2 I2S, 3 I2C, 2 UART, 2 PCIe, SDIO, 4.3V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C (広温度範囲対応可能) 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	82mm x 50mm (SMARC)

## エントリー AI 向け SOM モジュール

# SOM-3000

MediaTek Genio 350	eMMC 16GB
LPDDR4 2GB	WLAN+BT



### 1 MediaTek Genio 350 クアッドコア SoC 搭載

MediaTek 社製 ARM Cortex-A53 quad-core 2.0GHz を搭載。AI/IoT 産業用向け、長期安定供給可能な SoC。

### 2 複数のディスプレイやデュアルカメラ接続可能

4 レーン MIPI DSI および 4 レーン MIPI CSI は、複数のデバイスをサポート可能。

### 3 TOPS 0.3 の AI エンジン搭載

専用の APU (AI プロセッサ) と DSP を内蔵し、一般的なアプリケーションでより優れたパフォーマンスと低電力を両立した AI 処理を可能にします。その結果、より幅広い動作温度を実現しています。

部品番号	10GPE20G10020
搭載 SoC	MediaTek Genio 350 Quad-Core Processor ·Quad-Core Cortex A53 SoC@2.0GHz
メモリ	2GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	16GB
OS	Android 12 / Yocto 3.1
I/O	MIPI DSI, 2 MIPI CSI, HDMI 1.4, USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG, SPI, 3 I2C, 2 UART, 2 MIC-in, Line-out, ADC, SDIO 3.0, 6 GPIO, 2 PWM, 3.4~4.2V DC-in
使用環境	稼働温度: -40°C~85°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	45mm x 60mm

## 高性能シングルボードコンピュータ

# NEW VAB-5000

MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
LPDDR4 4GB/8GB	CSI x2



### 1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

### 2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

### 3 高速バス対応

USB 3.1 と GbE MAC などのさまざまな高速インターフェースを使用可能。4K@90Hz 再生。

部品番号	10GMU20600020
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ·Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ·Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	4GB/ 8GB LPDDR4X SDRAM
eMMC	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	eDP (Embedded DisplayPort), 2-Lane MIPI CSI, I/O expansion pin-header (supports GPIO x 40), UART, M.2 slot, Nano SIM card slot, Micro SD card slot, HDMI, 2 USB 3.1, GLAN, 3.5mm headphone jack, 12V DC in
使用環境	稼働温度: 0°C~60°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	100mm x 72mm (Pico-ITX)

## 高性能高機能シングルボードコンピュータ

# NEW VAB-7000

MediaTek Genio 1200	eMMC 16GB
LPDDR4 8GB	GLAN x1



### 1 MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな 4X Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

### 2 複数のカメラ及びディスプレイ接続可能

IoT 時代に対応すべき複数のカメラコネクションを装備。  
2x MIPI, DSI, 2x LVDS, 2x MIPI CSI。

### 3 TOPS4.8 AI エンジン搭載

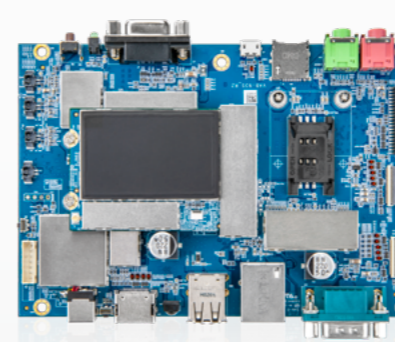
AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4.8 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 1200 Octo-Core Process ·Quad core Cortex A78 SoC@ 2.2GHz ·Quad core Cortex A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	32GB
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	2 MIPI DSI, LVDS, MIPI CSI-2, Micro SD card slot, Nano SIM slot, M.2 B-key connector, M.2 E key connector, VIO express header, RTC header, UART header, ADC/GPIO pin header, HDMI, 2 USB3.1, GLAN, Micro USB 2.0 port, 3.5mm audio phone jack, 2.5 phone jack for AHD camera, 12V DC-in
使用環境	稼働温度: 0°C~60°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	100mm x 72mm (Pico-ITX)

## エントリー AI 向けシングルボードコンピュータ

# VAB-3000

MediaTek Genio 350	eMMC 16GB
LPDDR4 2GB	CSI x2



### 1 MediaTek Genio 350 クアッドコア SoC 搭載

MediaTek 社製 ARM Cortex-A53 quad-core 2.0GHz を搭載。AI/IoT 産業用向け、長期安定供給可能な SoC。

### 2 多彩な接続方法

二つのカメラに対応可能。  
MIPI カメラ+USB カメラ二つのカメラを使用可能。

### 3 TOPS0.3 の AI エンジン搭載

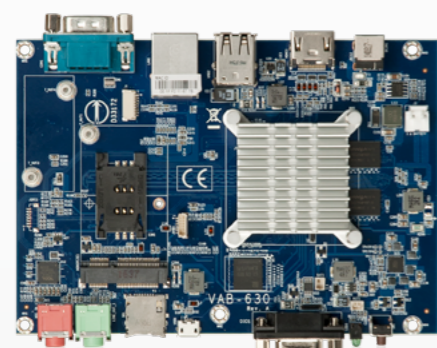
専用の APU (AI プロセッサ) と DSP を内蔵し、一般的なアプリケーションでより優れたパフォーマンスと低電力を両立した AI 処理を可能にします。その結果、より幅広い動作温度を実現しています。

部品番号	10GPD20G100A0
搭載 SoC	MediaTek Genio 350 Quad-Core Processor ·Quad-Core Cortex A53 SoC@2.0GHz
メモリ	2GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	16GB
OS	Android 12 / Linux Kernel Yocto 3.1
I/O	2 MIPI CSI, MIPI DSI or LVDS, miniPCIe slot, SIM card slot, MIC CONN, 2 Speaker CONN, Micro USB 2.0 OTG port, DIO port, Micro SD card slot, Headphone jack, COM(TX/RX), I/O expansion CONN( I2C/SPI/UART/PWM/ADC/GPIO), Microphone jack, HDMI, 2 USB2.0, LAN, 12V DC-in
使用環境	稼働温度: -40°C~85°C 稼働湿度: 0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	146mm x 102mm

## 3.5” ARM シングルボードコンピュータ

# VAB-630

DC-in	VIA Cortex-A9	eMMC 4GB
Fanless	DDR3 1GB	LAN x1



### 1 Cortex-A9 SoC 搭載

VIA 自社製 ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz WM8880 搭載。

### 2 豊富な拡張性を持つ I/O

LVDS あるいは HDMI へのビデオ出力、COM(TX/RX) を 1 ポート、GPIO を 10Pin、USB 2.0 を 3 ポート搭載。

### 3 バッテリーに接続可能

バッテリーに接続可能なボード設計。万が一の瞬断にも対策可能。

部品番号	10GHL126000A0
搭載 SoC	1.0GHz VIA WM8880 Cortex-A9 dual-core SoC
メモリ	1GB DDR3 SDRAM
eMMC	4GB
ストレージ	Micro SD Card Slot
対応 OS	Android 5.0 / Linux Kernel 3.4.5
I/O	MiniPCIe slot, SIM card slot, HDMI, USB 2.0, Micro USB 2.0, 2 LAN, DC Jack, 2 WiFi antenna connector, 2 Antenna hole(4G/5G), 3.5 phone jack, 12V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	146mm x 102mm

## 高性能 AI エンジン搭載エッジゲートウェイ

# NEW ARTiGO A5000

MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
4K	LPDDR4 8GB
DC-in	GLAN x1
Fanless	



### 1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

### 2 TOPS 4.0 の AI エンジン搭載

AI 演算を特化した APU を搭載して TOPS 4 の AI パフォーマンス。ハードウェア処理によって低消費電力で高いパフォーマンスを発揮することが可能。

### 3 コンパクトなスマートボックス

アンテナをシャーシに内蔵することで、小型化を実現したコンパクトシステム。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ·Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ·Hexa-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
ストレージ	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G57 MC3
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	Micro SD connector, Micro USB 2.0 port, Power button, Reset button, Download button, 12V DC In connector, GLAN port, 2 USB 3.0 ports, HDMI Port, 3.5mm phone jack (HPO/MIC)
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	117.92mm x 37.6mm x 80.8mm(WxHxD)

## 高性能 AI エンジン搭載高機能エッジゲートウェイ

# NEW ARTiGO A7000

MediaTek Genio 1200	eMMC 16GB
4K	LPDDR4 8GB
DC-in	GLAN x1
Fanless	



### 1 MediaTek Genio 1200 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな 4X Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能オクタコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

### 2 高速転送インターフェイス

二つの USB3.1 と二つの GLAN を搭載し、周辺機器と高速接続することが可能。

### 3 4K 解析度サポート

最新のマルチメディア規格および 4K マルチディスプレイに対応可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 1200 Octa-Core Processor ·Quad-core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ·Quad-core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
eMMC	16GB
OS	Android 13 / Yocto 4.0 / Debian 12
I/O	Power button, Reset button, USB 2.0, Micro HDMI input, HDMI, USB 3.0, GLAN, LVDS, AHD, SD card slot, 12V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	117.92mm x 37.6mm x 80.8mm(WxHxD)

## エントリー AI エンジン搭載ゲートウェイ

# ARTiGO A3000

MediaTek Genio 350	eMMC 16GB
DC-in	LPDDR4 2GB
Fanless	LAN x1



### 1 MediaTek Genio 350 クアッドコア SoC 搭載

MediaTek 社製 ARM Cortex-A53 quad-core 2.0GHz を搭載。AI/IoT 産業用向け、長期安定供給可能な SoC。

### 2 TOPS 0.3 の AI エンジン搭載

専用の APU (AI プロセッサ) と DSP を内蔵し、一般的なアプリケーションでより優れたパフォーマンスと低電力を両立した AI 処理を可能にします。




### 3 ワイヤレス接続対応

IoT 時代に対応すべき無線 LAN を装備。Dual-band 802.11ac Wi-Fi と Bluetooth 5.0 を使用可能。

部品番号	ATG-A3000-1Q20A0
搭載 SoC	MediaTek Genio 350 Quad-Core Processor ·Quad-Core Cortex A53 SoC@2.0GHz
メモリ	2GB LPDDR4 SDRAM
ストレージ	16GB eMMC
グラフィック	ARM Mali-G52 3EE MC1 GPU
OS	Android 12 / Yocto 3.1
I/O	MiniPCIe, SIM card, Micro USB 2.0 OTG, DIO, Micro SD card, 2 Audiojack, HDMI, 2 USB 2.0, COM, LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	154.4mm x 27mm x 106.5mm(WxHxD)

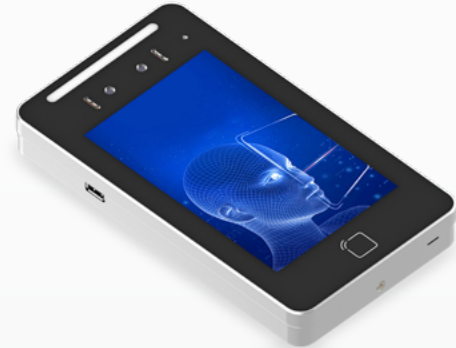
## アクセス制御システム

### NEW Access Control System (POC)

			MediaTek Genio 700	eMMC 16GB
			LPDDR4 8GB	WLAN+BT

ARM  
POWERED

MEDIATEK



#### 1 MediaTek Genio 700 オクタコア SoC 搭載

要求の厳しい AI やパフォーマンスを重視する IoT アプリケーション向けに設計された、最大 2.2GHz で動作するプレミアムな Arm Cortex-A78 プロセッサを搭載した高性能デュアルコア CPU および高度な 3D グラフィックスに対応可能。

#### 2 複数カメラの搭載によるセキュリティ向上

RGB カメラと IR カメラ、二つのカメラを搭載し、複数のカメラによる顔認証の精度向上を図ることで、なりすましをより確実に防止します。不正なアクセスを検知し、より信頼性の高いセキュリティを実現します。



#### 3 セキュリティ非接触型スマートカードリーダー

ISO 14443 Type A 非接触型カードをサポート可能。

部品番号	TBD
搭載 SoC	MediaTek Genio 700 Octa-Core Processor ・Dual-Core Cortex-A78 SoC@ 2.2GHz ・Hex-Core Cortex-A55 SoC@ 2.0GHz
メモリ	8GB LPDDR4 SDRAM
モニター	7.0" 1200x1920 10:16 LCD
eMMC	16GB
OS	Android 13
I/O	2 MIPI 1080p / 30fps camera(RGB+IR), 1 USB 2.0 Type A, 1 RJ45, 2 GPI Input (10mA), 2 GPO Output (max. 3A), 1 RS-485, 1 UART for debug, 1 Micro USB, 12V DC-IN
NFC	ISO / IEC 14443 Type A/B
使用環境	稼働温度：0°C~50°C 稼働湿度：0%~90% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	230mm x 129mm x 28mm(WxHxD)

## x86 クアッドコア搭載マザーボード

### EPIA-M930

		Intel Celeron J6413	COM x 2
		LVDS x 2	GLAN x2

intel  
INSIDE



#### 1 Intel クアッドコア CPU 搭載

Intel 社製 1.8GHz Celeron クアッドコアプロセッサ J6413 搭載。TDP はわずか 10W、高性能・低消費電力両立可能。

#### 2 豊富な I/O および拡張

2つの USB 3.1 ポート、4つの COM ポート及び 8 ビットデジタル I/O を備えています。また、高速ネットワークに対応するギガビットイーサネットを2つ搭載しています。



#### 3 2LVDS マルチ画面出力対応

産業用途に必要なとされる LVDS パネルとの接続ポートを2つ搭載。HDMI と組み合わせをすれば3つ画面への出力も可能。

部品番号	10GQH18F000A0
搭載 CPU	Intel Celeron Processor J6413 1.8GHz
メモリ	Max 32GB DDR4 SODIMM
グラフィック	第 10 世代インテル® プロセッサ・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス
I/O	1 HDMI, 2 LVDS, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 4 COM, 2 GLAN, 8 GPIO, PCIe x1 slot, SATA, 2 M.2 slots, SIM card slot, Audio jack, 12V DC-in
使用環境	稼働温度：0°C~60°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	170mm x 170mm (Mini-ITX)

## x86 ファンレス・コンパクトシステム

### AMOS-3007

		Intel ATOMX6413E	COM x2
		HDMI x2	GLAN x2

intel  
INSIDE



#### 1 Intel クアッドコア CPU 搭載

Intel 社製 1.5GHz ATOM クアッドコアプロセッサ X6413E 搭載。TDP はわずか 9W、高性能・低消費電力両立可能。

#### 2 豊富な I/O および拡張

2つの USB 3.1 ポート、4つの COM ポート及び 8 ビットデジタル I/O を備えています。また、高速ネットワークに対応するギガビットイーサネットを2つ搭載しています。

#### 3 -20°C~70°Cワイドレンジ温度対応

システムの稼働温度は -20°C~70°Cまで幅広いため、温度に厳しい屋外用、半屋外用にも対応可能。

部品番号	AMOS-3007-1Q15A0
搭載 CPU	Intel Atom Processor X6413E 1.5GHz
メモリ	Max 32GB DDR4 SODIMM
グラフィック	第 10 世代インテル® プロセッサ・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックス
I/O	2 HDMI, 2 USB 3.1, 2 Lockable USB 2.0 ports, 2 COM ports for RS-232/422/485, 2 Gigabit Ethernet, 1 DIO port for 8-bit GPIO, 1 Line-out, 1 Mic-in, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度：-20°C~70°C 稼働湿度：0%~95% @45°C (結露なきこと)
外形寸法	170mm x 48.5mm x 126mm(WxHxD)



# VIA Mobile360 製品

## 一体型 AI ドライブレコーダー

### VIA Mobile360 D700

DC-in Fanless	ADAS+DSS 2カメラ	CAN bus 搭載
	4G LTE 対応	DC-in 9V-36V



#### 1 AWS でフリート管理を簡単に

ドライブレコーダーに加え、AWS Cloud の Fleet management で、車両ステータスが一目瞭然、管理が簡単に。

#### 2 B2B 向け開発パッケージ

独自の機能を開発できるように完全な SDK ツールとレファレンスアプリを提供し、幅広いニーズをサポートできます。

#### 3 AI 安全システム搭載

安全運転のための DSS、イベント録画機能あり。FCW (前方衝突警告)、LDW (車線逸脱警報) も搭載。

部品番号	M360-D700-3D08A0
搭載 SoC	800MHz ARM Cortex-A53 dual-core SoC
メモリ	512MB DDR3L DRAM
Storage	256MB SPI Flash Memory 1 Micro SD Card slot (Max 512GB)
OS	Linux Kernel 4.1.0
I/O	1 Micro USB 2.0 port, 1 Micro SD Card slot, 1 Micro SIM Card slot, 1 12-pin power connector for 6 GPIO, CAN bus, ACC, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度：-20°C~70°C
外形寸法	124.52mm x 41.25mm x 95.60mm(WxHxD)

## セパレート型 AI ドラレコシステム

### VIA Mobile360 M800

DC-in Fanless	IP67 対応	ISO 16750-3 振動・衝撃
	MAX 3カメラ 接続可能	DC-in 9V-36V



#### 1 AI 安全システム搭載

安全運転のための DSS (ドライバー安全システム)、イベント録画機能あります。FCW (前方衝突警報)、LDW (車線逸脱警報) も搭載。

#### 2 3カメラまで対応

コンパクトなカメラを最大3台搭載可能、幅広い中型、大型車両の設置や安全性の確保に最適。

#### 3 多彩な開発支援

ソフトウェア開発のための SDK ツール、レファレンスアプリを提供し、多様な車両向け I/O を対応でき、幅広いニーズをサポートできます。

部品番号	M360-M800-6D12A2
搭載 SoC	1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC with deep learning accelerator
メモリ	1GB DDR3 SDRAM
Storage	512MB SPI NAND Flash ROM 1 Micro SD Card Slot (Max 512GB)
OS	Embedded Linux
I/O	1 M12 Display avionic connector, 1 M12 DIO avionic connector, 1 M12 CAN/COM avionic connector, 9-36V DC-in, 1 M12 LAN avionic connector, 1 Micro SIM Card Slot
使用環境	稼働温度：-20°C~70°C 稼働湿度：0%~95% (結露なきこと)
外形寸法	178mm x 53.8mm x 194.6mm(WxHxD)

## フォークリフト安全システム

# VIA Mobile360 M500



IP67 対応	ISO 16750-3 振動・衝撃
DDR3 1GB	DC-in 9V-36V



### 1 WorkX App 対応

VIA WorkX モバイルアプリで設定、キャリブレーションを簡単に。

### 2 AI 検知システム搭載

PD（歩行者検知） & DSS（ドライバー安全）カメラによって、フォークリフトに接近する歩行者を検知して警告し、ドライバーの安全意識を高めます。

### 3 豊富なオプション

PD カメラ、DSS カメラ、7 インチディスプレイパネル、スピードセンサーキットなど、ニーズに合わせた多彩な組合せが選べます。

部品番号	M360-M500 (with 2PD+DSS) M360-M500 (with 3PD)
搭載 SoC	1.2GHz ARM Cortex-A7 dual-core SoC with deep learning accelerator
メモリ	1GB DDR3 SDRAM
Storage	512MB SPI NAND Flash ROM 1 Micro SD Card Slot (Max 512GB)
OS	Embedded Linux
I/O	2 M12 8-pin DIO avionic connectors, 1 M12 CAN/COM avionic connector, 1 M12 speaker avionic connector, 1 Micro SD card slot, 1 Micro SIM card slot, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度：-20°C~60°C 稼働湿度：0%~95%（結露なきこと）
外形寸法	178mm x 53.8mm x 194.6mm (WxHxD)

## 車載 IoT、MaaS 向けソリューション

# IVT01



MediaTek Genio 500	DDR4 4GB
eMMC 16GB	DC-in 9V-36V



### 1 AI 搭載 Octa-core SoC

MediaTek 社製強力な ARM Cortex-A73 + Cortex-A53 Octa-Core 2.0GHz を搭載。さらに AI 演算を特化した APU 搭載し、ハードウェアから AI の性能を向上させます。

### 2 多彩な接続方法

車載 IoT 向けに多彩な接続方法を装備。各種無線通信仕様、CAN/RS232 インターフェース、フロントカメラ、光センサ、加速度センサーに対応。

### 3 車載規格を満たした高信頼性

電圧瞬断対策、アイドリングストップしても 90 秒間電源供給が可能。幅広い温度、湿度の環境でも耐えられる高い信頼性を持った設計になっています。

部品番号	IVT01-1Q10A0
搭載 SoC	MediaTek Genio 500 octo-core Processor ・Quad-Core Cortex-A73 @ 2.0GHz ・Quad-Core Cortex-A53 @ 2.0GHz
メモリ	4GB LPDDR4 SDRAM
Storage	16GB eMMC Flash Memory
OS	Android 10
I/O	1 CAN, 5 GPI and 1 GPO, 2 RS232, 1 USB 2.0 host, 1 Micro-SIM connector, 1 3.5mm phone jack, 1 MIPI DSI connector, 1 MIPI CSI-2 connector, 1 MiniPCIe slot, 9-36V DC-in
使用環境	稼働温度：-10°C~60°C
外形寸法	218mm x 37mm x 145mm (WxHxD)

## ■ お問い合わせ先

### ■ Japan

VIA Technologies Japan株式会社

〒150-0011 東京都渋谷区  
東3丁目15番7号  
ヒューリック恵比寿ビル6階

- Tel: 81-3-5466-1637
- Fax: 81-3-5466-1638
- [embedded@viatech.co.jp](mailto:embedded@viatech.co.jp)

### ■ Taiwan Headquarters

威盛電子股份有限公司

1F, 531, Zhongzheng Rd.,  
Xindian Dist.  
New Taipei City 231, Taiwan

- Tel: 886-2-2218-5452
- Fax: 886-2-2218-9860
- [embedded@via.com.tw](mailto:embedded@via.com.tw)

### ■ USA

VIA Technologies, Inc.

940 Mission Court, Fremont,  
CA 94539, USA

- Tel: 1-510-687-4688
- Fax: 1-510-687-4654
- [embedded@viatech.com](mailto:embedded@viatech.com)

### ■ China

VIA Technologies Co., Ltd.

Tsinghua Science Park Building 7  
No.1 Zhongguancun East Road,  
Haidian District, Beijing,  
100084 P.R.C

- Tel: 86-10-59852288
- Fax: 86-10-59852299
- [embedded@viatech.com.cn](mailto:embedded@viatech.com.cn)